

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2113
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：牙體技術師

科 目：牙體技術學（二）（包括固定義齒技術學科目）

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 根據 Rosenstiel SF 等人的研究，一般認為美觀的上顎正中門齒寬度約為高度的：
(A)55% (B)66% (C)77% (D)88%
- 下列何種金屬表面處理法，最適用於貴重金屬合金（precious metal alloy）薄蓋冠？
(A)以碳鋼磨針（carbide bur）輕輕研磨
(B)使用碳化矽磨錐（carborundum point）大範圍修磨
(C)使用 200 μ m 氧化鋁粒子以高壓快速噴砂
(D)以 1100~1200°C 加熱處理十五分鐘以去除殘餘氣體（degassing）
- 除氣加熱處理後的貴重金屬薄蓋冠，如欲使其灰白化以提昇陶瓷色調的表現性，最適合使用下列那一種毒性較低的溶液進行表面處理？
(A)46% 氫氟酸（HF） (B)30% 鹽酸（HCl）
(C)70% 酒精（isopropyl alcohol） (D)37% 磷酸（phosphoric acid）
- 大白齒支柱牙的牙周已經變差，導致根叉侵犯（furcation involvement），牙醫師為此牙製作牙冠時，修磨了“長凹槽”（fluting），下列關於此長凹槽的敘述何者錯誤？
(A)此特殊修形位於根叉處上方邊緣的軸向壁（axial wall）上
(B)此長凹槽與牙冠置入軸（path of insertion）平行
(C)此作法是為了容易保持根叉處的牙齦健康
(D)此處的牙冠邊緣厚度比其他區域的邊緣厚
- 比色時負責比色的人員眼睛與患者距離約為多少最適當？
(A)10 公分 (B)25 公分 (C)50 公分 (D)一公尺
- 下列有關外染的項目，那一項最不可能成功？
(A)調整色別（hue） (B)增加明度（value）
(C)增加色度（chroma） (D)染出裂線（crack line）般的紋路
- 下列有關牙科全瓷冠系統之分類與商品名之配對，何者錯誤？
(A)以白榴石玻陶為材料之壓鑄式陶瓷：Finesse
(B)以焦矽酸鋰玻陶為材料之壓鑄式陶瓷：Empress II
(C)玻璃滲透式陶瓷：CEREC InLab
(D)氧化鋁陶瓷：OPC

- 8 下列何種全瓷冠系統，主成分並非採用氧化鋯（Zirconia）材料？
(A) Cercon (B) Everest (C) Lava (D) Empress I
- 9 要改變烤瓷牙切緣側的透明度，下列何者最正確？
(A) 在切端唇面以藍色塗抹以顯示更透明的感覺
(B) 在切端舌面以白色塗抹以顯示更透明的感覺
(C) 在切端舌面以白色塗抹以顯示較不透明的感覺
(D) 在切端舌面以藍色塗抹以顯示較不透明的感覺
- 10 下列有關高含量氧化鋁全瓷冠支架與氧化鋯全瓷冠支架的材料性質比較，何者最正確？
(A) 彈性係數：氧化鋁 > 氧化鋯；膨脹係數：氧化鋁 > 氧化鋯
(B) 彈性係數：氧化鋁 > 氧化鋯；膨脹係數：氧化鋁 < 氧化鋯
(C) 彈性係數：氧化鋁 < 氧化鋯；膨脹係數：氧化鋁 < 氧化鋯
(D) 彈性係數：氧化鋁 < 氧化鋯；膨脹係數：氧化鋁 > 氧化鋯
- 11 使用鈦金屬為瓷融合金屬牙冠時，下列敘述何者為誤？
(A) 鈦金屬表面氧化膜比一般燒結合金更厚，有利於烤瓷與金屬之間的結合力
(B) 鈦金屬的熱膨脹係數比一般燒結合金更低，需使用特殊的瓷粉
(C) 鈦金屬容易因為高溫產生變形，因此要搭配使用低溫熔瓷
(D) 鈦金屬使用的低溫瓷在烘烤時因為殘留碳，很容易變成灰色調
- 12 下列何者與植體上部構造體燒瓷完成後在牙頸部發生裂縫無關？
(A) 鑄接金屬時鑄造不全使邊緣露出專用元件的成分
(B) 金屬調整加工時修磨過多而露出專用元件的成分
(C) 除氣（degassing）後專用元件表面產生較厚氧化膜
(D) 專用元件與鑄造合金的熱膨脹係數不同
- 13 下列何種金屬合金在烤瓷前一定要做真空高溫烘烤？①貴重金屬系合金（金含量 70%以上）②半貴重金屬系合金（semi-precious alloy）③非貴重金屬系合金（Ni-Cr）
(A) ①②③ (B) 僅①② (C) 僅②③ (D) 僅①③
- 14 下列有關使用半貴重金屬合金烤瓷牙時，發生陶瓷變色的情況與原因，何者最正確？
(A) 變綠色是因為含有銅 (B) 變黃色是因為含有鐵
(C) 變灰色是因為含有銀 (D) 變藍色是因為含有鈮
- 15 當鑄造冠移除包埋材之後發現牙冠上有破洞時，下列何者是最不可能的原因？
(A) 蠟型太薄 (B) 鑄造金屬不足 (C) 去蠟過程不完全 (D) 包埋材水粉比太高
- 16 下列有關製作嵌體時，窩緣斜面（marginal bevel）的敘述，何者不正確？
(A) 無論何種嵌體材料的窩緣斜面，都是設計成 45 度傾斜度
(B) 可保護牙釉質（enamel）窩緣
(C) 利用壓接來補正邊緣封鎖
(D) 需配合使用緣端強度大的材料
- 17 下列何者無法增加全部覆蓋冠的抵抗力（resistance）？
(A) 增加全部覆蓋冠內面的粗糙度（roughness）
(B) 增加支柱牙上的補助維持型態，如固持溝（retention groove）、固持盒（retention box）等
(C) 減少支柱牙軸壁的斜度（taper）
(D) 增加支柱牙的高度

- 18 橋體的金屬厚度會影響固定牙橋的剛性（rigidity），若將橋體的金屬厚度減半，則彎曲量會增加為多少倍？
(A)二倍 (B)三倍 (C)四倍 (D)八倍
- 19 臨床比色時最好在什麼顏色的背景中比色？
(A)淺綠色 (B)淺黃色 (C)淺灰色 (D)淺紅色
- 20 為彌補鑄造冷卻後所產生的金屬收縮，包埋時最適合使用下列何種方法？
(A)將鑄造環（casting ring）內的襯墊（liner）輕輕貼於鑄造環
(B)蠟型包埋後將整個鑄造用模型放在室溫中等包埋材硬化
(C)減少包埋粉的混合時間（mixing time）
(D)增加包埋材的水粉比（water-powder ratio）
- 21 在連接切開的牙橋時，下列那一個步驟所採用銲接金屬的熔點與牙橋所用的金屬相同？
(A)前銲（preceramic soldering） (B)後銲（postceramic soldering）
(C)雷射熔接（laser welding） (D)鎢極惰性氣熔接（tungsten inert gas welding）
- 22 患者因左上正中門齒缺牙求診，經測量發現缺牙區的寬度為 8 mm，而相鄰之右上正中門齒寬度為 9mm，患者不願修磨牙齒，下列何種方法在視覺上最可以改善兩個門齒寬度不同的情況？
(A)將左上正中門齒的瓷牙表面的弧度增加
(B)將左上正中門齒與鄰牙的接觸區更向唇側移
(C)在左上正中門齒的瓷牙上增加垂直方向的條紋
(D)將左上正中門齒的鄰接面外染成較深色
- 23 下列四種合金的熔點由低至高依序排列，何者最正確？
(A)Type IV 金合金 < 鈮銀合金 < 鈷鉻合金 < 鈦合金
(B)鈮銀合金 < Type IV 金合金 < 鈷鉻合金 < 鈦合金
(C)鈮銀合金 < Type IV 金合金 < 鈦合金 < 鈷鉻合金
(D)Type IV 金合金 < 鈮銀合金 < 鈦合金 < 鈷鉻合金
- 24 下列何種銲接法屬於壓接熔接？
(A)電漿熔接 (B)點銲熔接 (C)黃銅熔接 (D)紅外線銲接
- 25 在牙橋的結構中，缺牙部位的構造稱為：
(A)支柱牙 (B)橋腳齒 (C)固位體 (D)橋體
- 26 若以窩洞的形態來分類，下列敘述何者最正確？
(A)布拉克氏 I 級窩洞為外側性窩洞
(B)外開形（tapered form）為嵌體窩洞的基本形態
(C)箱形（box form）又稱作便利形態
(D)外側性窩洞必須有作出釘柱及溝等之輔助的保持形態
- 27 下列何種設計，屬於延長牙橋？①套疊式牙橋（telescope type bridge） ②懸臂式牙橋（cantilever bridge） ③雙重冠式牙橋（konuskrona type bridge） ④馬里蘭牙橋（Maryland bridge） ⑤末端游離牙橋（free-end bridge） ⑥延伸式牙橋（extension bridge）
(A)僅①③④ (B)僅②⑤⑥ (C)僅②③⑤⑥ (D)①②③④⑤⑥

- 28 下列有關研磨器具與材料之配對，何者錯誤？
(A)鑽石磨錐（diamond point）使用在陶瓷材料粗研磨
(B)砂紙錐（paper cone）與皮輪（buff）使用在鑄造冠與陶瓷材料的粗研磨
(C)碳化矽磨錐（carborundum point）、圓切盤使用在鑄造冠的粗研磨或鑄造冠的鑄道切斷
(D)鎢鋼鑽針（tungsten carbide bur）使用在樹脂的形態修正或鑄造冠的粗研磨
- 29 下列有關無環式包埋法（ringless investment technique）的敘述，何者最正確？
(A)採用較低強度的包埋材
(B)包埋材多為磷酸鹽結合包埋材（phosphate-bonded investment）
(C)適用於低熔點的鑄造金屬
(D)膨脹量比採用鑄造環包埋法小
- 30 下列何種金屬融解加熱裝置的加熱溫度範圍最大？
(A)瓦斯-空氣 (B)瓦斯-氧氣 (C)氧氣-乙炔 (D)白金線電熱爐
- 31 下列有關多顆缺牙的長徑距牙橋之敘述，何者最正確？
(A)宜採用金含量較高的金屬以免使用後發生陶瓷破裂的情形
(B)應採用多處銲接以達到完全密合的程度
(C)若支柱牙的高度較不足時，宜在頰側與舌側增加固位溝（retention groove）以提高固持力（retention）
(D)當橋體數目增加時，牙橋受力時的變形量會呈相同倍數增加
- 32 準備銲接已切開的瓷融合金屬牙橋時，若所用的金屬為銀-鈦合金，熔點範圍：1232~1304°C，牙橋上已烤瓷，熔點（fusing point）：982°C，此時有兩種銲劑，其熔點範圍（melting range）分別為：①710~743°C ②1110~1127°C。請問那一個組合是最正確的材料選擇與銲接方法？
(A)①，前銲 (B)①，後銲 (C)②，前銲 (D)②，後銲
- 33 患者只缺右上第一大臼齒，製作右上第二小白齒與第二大臼齒三單位的固定牙橋時，若牙醫師要求製作成群體功能（group function）的咬合方式，以下敘述那一項不正確？
(A)宜使用面弓轉移來置位上顎模型
(B)面向咬合器，咬合器上部向你的左方移動時，13、14、15×17 與對咬牙皆有接觸
(C)需要無佩戴暫時牙橋的中心咬合位（ICP）之咬合紀錄
(D)宜使用半調節咬合器
- 34 下列何者最無法避免牙橋金屬支架變形？
(A)製作蠟型時先將橋體與支台齒蠟型分開刻蠟，包埋前再相連
(B)相連橋體與支台齒蠟型時應在連結部兩側同時以蠟連結，以減少兩側不一樣的收縮率
(C)連接鑄道時設計較大的橫槓流道
(D)使用專用於連結部的蠟來連結各蠟型之間的空隙
- 35 下列關於鑄道放置位置之敘述，何者最不合適？
(A)瓷金屬融合冠（porcelain fused to metal crown）放在舌側
(B)針嵌體（pinledge）放在最厚部位且與釘子的方向平行
(C)II 級 MOD 嵌體（inlay）放在遠心鄰接面
(D)全金屬牙冠放在非功能性咬頭

- 36 下列那一個步驟使包埋材膨脹量最大？
(A)將一層鑄造環襯裡 (ring liner) 密貼壓扁在鑄造環中
(B)將一層鑄造環襯裡弄濕輕貼在鑄造環中
(C)將一層乾的鑄造環襯裡輕貼在鑄造環中，並在包埋材硬化過程中將鑄造環浸在水中
(D)將兩層鑄造環襯裡弄濕輕貼在鑄造環中
- 37 使用 VITAPAN 3D-Master 比色板的比色順序，下列何者最正確？
(A)色相→明度→彩度 (B)明度→彩度→色相 (C)色相→彩度→明度 (D)彩度→明度→色相
- 38 下列有關陶瓷與金屬相接處的設計，那一項不正確？
(A)需距離中心咬合點 1 mm 以上
(B)在前牙舌側應使對咬牙與陶瓷接觸，以免金屬磨耗較快
(C)由斷面型態上來看，兩者相接最好是對接型態 (butt joint)
(D)在支持區應將金屬部分的蠟型刻成銳角以利於燒瓷
- 39 下列有關暫時牙橋的敘述，何者不正確？
(A)使用壓克力樹脂製作時會有嚴重收縮放熱的情況，須再重襯以達到密合的程度
(B)可用光聚合複合樹脂放在唇側面，比使用壓克力樹脂美觀
(C)在連接體 (connector) 部分不可加厚以免食物容易堆積
(D)其彈性係數比金屬低，長徑距之牙橋會有鬆脫的情況
- 40 下列有關牙橋之設計與口腔衛生的相關性，何者不正確？
(A)牙橋連接體與牙肉之間的距離應要保持讓患者可以清潔的程度
(B)若採用瓷融合金屬牙橋，橋體底部烤瓷會比金屬表面更容易清潔
(C)橋體底部若有燒瓷，則粗研磨後應立即上釉增加表面細緻度，以利於清潔
(D)連接體底部採用圓盤面磨光後再上釉以利於清潔
- 41 下列何者非氧化鋯 (zirconia) 的相安定劑？
(A)氧化釷 (Y_2O_3) (B)氧化鈣 (CaO) (C)氧化鎂 (MgO) (D)氧化鈦 (TiO_2)
- 42 使用於陶瓷燒付合金後鐸時，鐸劑熔融點約為：
(A)200~400°C (B)700~800°C (C)1050~1200°C (D)1100~1250°C
- 43 下列有關下顎門齒切齒點所描繪出之邊際運動的敘述，何者最正確？
(A)CR 為中心咬合 (B)CO 為正中關係 (C)RP 代表最大開口位 (D)ICP 代表咬頭嵌合位
- 44 下列有關支柱牙橋體設計以力學方面為考量之敘述，何者錯誤？
(A)橋體愈長，撓曲量增加 (B)橋體愈長，支柱牙荷重負擔加大
(C)橋體愈長，強度增加 (D)橋體愈長，連接部應力增加
- 45 下列最適合製作活動義齒支架、牙鉤 (clasp) 與牙橋 (bridge) 之 ADA 規格鑄造用金合金為：
(A)Type I (B)Type II (C)Type III (D)Type IV
- 46 下列有關空洞橋體 (hollow pontic) 的製作方法，何者錯誤？
(A)牙橋用蠟務必用硬質蠟，以防止空洞橋體變形
(B)空洞內部須修飾成圓滑面，不可形成倒凹區 (undercut area)
(C)空洞開口部位，應該形成銳利的隅角
(D)橋體的基底面與齒槽面間應約有 0.5~0.8 mm 的燒瓷空間

- 47 下列有關金屬陶瓷牙橋連接體 (connector) 設計原則的敘述，何者錯誤？
(A)爲了美觀，要確保連結齒間的切緣楔隙 (incisal embrasure) 及唇、頰側方向的切入空間
(B)爲了衛生，要打開齒頸楔隙 (cervical embrasure)，連接體的下部不要作成 U 字型
(C)爲了強度，咬合方向上、下的增加，優於唇 (頰)、舌側的厚度增加
(D)連接體的下部，儘可能用陶瓷回復
- 48 下列關於比色 (shade taking) 時光源的設定條件，請選出適合之選項：①上午十時至下午三時之太陽光較理想 ②從南側窗戶入射之間接自然光 (JIS 的規定) ③選用低演色性 (Color Rendering Index) 螢光燈 ④演色評價至 99 的「演色 AAA」並有註明 EDL 的螢光燈 ⑤色溫度在 5,000~6,500 K ⑥作業面照度 (流明) 在 1,000 lx~1,500 lx
(A)僅①②③④ (B)僅①②③⑤ (C)僅③④⑤⑥ (D)僅①④⑤⑥
- 49 下列有關 VITA 比色板的敘述，何者錯誤？
(A)B1 最明亮 (B)臨床上選擇 A 色相頻率較高
(C)C4 最暗 (D)D 色相略帶微許灰色
- 50 爲符合人類牙齒整體分布的特性，下列有關比色板之設計何者最正確？
(A)高彩度，高明度 (B)高彩度，低明度 (C)低彩度，高明度 (D)低彩度，低明度
- 51 全陶瓷中含 $\geq 15\text{wt}\%$ 矽底陶瓷 (silica based ceramics)，而且主成分是焦矽酸鋰玻璃陶瓷 (Lithium-disilicate glass ceramics) 的材料商品名爲下列何者？
(A)OPC (B)e.max press (C)In-Ceram Zirconia (D)NANOZR
- 52 下列何者爲氧化鈮添加型正方晶氧化鋯多結晶體之簡稱？
(A)SZ (B)PSZ (C)Y-TZP (D)HIP
- 53 下列有關後鐸法的注意事項，何者錯誤？
(A)使用爐外鐸接法
(B)爲防止陶瓷與鐸接包埋材接觸，可在陶瓷表面用蠟、被覆保護
(C)助熔劑儘可能少量使用
(D)包埋砂塊 (block) 儘可能小塊
- 54 YAG 雷射屬於何種雷射？
(A)固體雷射 (B)半導體雷射 (C)液體雷射 (D)氣體雷射
- 55 有關鈦金屬鐸接的方法，下列何者屬於功率光束 (power beam)？
(A)鎢極惰性氣體 (TIG) (B)金屬惰性氣體 (MIG)
(C)電漿弧熔接 (PAW) (D)電子束 (EB) 熔接
- 56 下列有關牙科鐸劑的所要性質，何項錯誤？
(A)熔融點比母金低 50~200°C (B)熔融時的表面張力很大
(C)母金金屬表面有很好的浸潤性，並且容易擴散 (D)凝固後不可有多孔質 (porous) 的物質
- 57 下列有關鐸劑熔點過熱及偏低時，所產生之缺陷，何者爲非？
(A)燒穿 (B)滲透不全
(C)鈎 (clasp) 等加工線材會硬化 (D)空泡 (voids) 產生，造成鐸接部脆化
- 58 下列全瓷冠系統何者屬於玻璃滲透式陶瓷之產品？
(A)Empress II (B)Procera (C)In-Ceram Spinell (D)Cercon
- 59 下列有關各種薄蓋冠透光率，從最透光至最不透光的順序，何者最正確？①Empress II ②In-Ceram alumina ③Lava zirconia ④Procera alumina
(A)①②③④ (B)①④③② (C)①④②③ (D)④①③②

- 60 下列操作順序何者最正確？①將鑄造冠與鑄道分開 ②將鑄造體內冠的小突起磨除 ③調整鄰接面的接觸 ④確認內冠密合單齒模 ⑤咬合型態粗研磨 ⑥調整咬合接觸 ⑦磨光
(A)①②③④⑤⑥⑦ (B)②①④③⑤⑦⑥ (C)①⑤②④③⑥⑦ (D)①③②④⑥⑤⑦
- 61 下列何者是助熔劑 (flux) 的功用？①防止合金熔融時表面氧化 ②增加合金的流動性 ③降低合金熔點溫度 ④加速金屬與空氣接觸 ⑤溶解合金表面的氧化物
(A)僅①③④⑤ (B)僅①②③⑤ (C)僅②③④ (D)僅①②⑤
- 62 如下圖，當鑄造物表面出現翅膀狀之薄型突出物時，那些是可能的原因？①包埋時沒有噴表面活性劑 ②包埋材的水粉比錯誤 ③蠟型太貼近鑄造環邊緣 ④鑄造環加熱速度太快 ⑤蠟型太薄
(A)①②③④⑤
(B)僅①②③
(C)僅②③④
(D)僅③⑤
- 
- 63 下列有關瓷融合金屬 (porcelain fused to metal) 牙橋的金屬支架“前加熱處理”之敘述，何者正確？
①目的是為形成與陶瓷鍵結的氧化膜 ②目的是為了解除鑄造時產生的應變 ③要將包埋材以噴砂清除乾淨後再進行 ④要在真空中進行 ⑤在鑄道連接狀態下操作
(A)僅①③④ (B)僅②④⑤ (C)僅②⑤ (D)僅③④
- 64 下列圖形有關各種橋體設計的強度，由強至弱的排列何者最正確？（圖形中，灰色部位表示金屬）
a  b  c  d 
(A)a > b > c > d (B)a > b = c > d (C)d > c > b > a (D)d > c = b > a
- 65 有關“高均壓壓製氧化鋯陶瓷 (high-isostatic-pressed zirconium dioxide)”與“部分燒結型氧化鋯陶瓷 (partially sintered state zirconium dioxide)”，下列敘述那一項錯誤？
(A)高均壓壓製氧化鋯陶瓷較耗損銑削磨針 (milling bur)
(B)高均壓壓製氧化鋯陶瓷在銑削時容易發生龜裂
(C)部分燒結型氧化鋯陶瓷在銑削後再燒結
(D)部分燒結型氧化鋯陶瓷在燒結時會發生 10~20% 的膨脹，因此要設定補償尺寸
- 66 在瓷堆築法中，能一次大量抹添瓷，且可減少水分過多的情形，此法為：
(A)筆刷法 (B)震動法 (C)沉澱法 (D)調刀法
- 67 在築蠟 (wax up) 的方法中由 E.V. Payne 確立，其後有 P.K. Thomas 和 H.C. Lundeen 各自設計出之牙尖-咬窩關係、牙尖-峭關係之方法為：
(A)軟化壓接法 (B)浸漬法 (C)添蠟法 (D)蠟錐體技術
- 68 下列有關印模材之敘述，何者錯誤？
(A)橡膠類屬於不可逆彈性印模材 (B)藻膠類 (alginate) 屬於可逆性彈性印模材
(C)瓊膠類 (agar) 屬於可逆彈性印模材 (D)印模用石膏屬於不可逆非彈性印模材
- 69 下列有關牙冠贗復物之分類，何者不是歸類為局部鑲面冠 (partial veneer crown)？
(A)根柱牙冠 (post crown) (B)針式嵌體 (pinledge)
(C)鄰接面半冠 (D)3/4 牙冠

- 70 牙冠補綴物在試戴時往往在支柱牙上來回好幾次，此時爲了防止傷害到牙冠邊緣，一般會設置何種構造？
(A)固位珠 (retention beads) (B)貯積球 (reservoir)
(C)鑄道成形 (spruing) (D)可撤式小球形突出物 (removal knob)
- 71 支台齒與贗復物插入方向相對抗之力量稱爲：
(A)保持力 (B)抵抗力 (C)剪應力 (D)固位力
- 72 下列有關牙橋的設計在構造力學之考慮，何者正確？①設計時宜考慮 Ante's law 的法則與 Duchange 指數 ②支柱牙隔著正中線左右均等配製時，牙橋的平衡性較差 ③把支柱牙連接起來的形態呈現多角形，而且面積越大，牙橋越安定 ④長徑距的牙橋若中間有支柱牙，所加諸的力量須以活動式來解放
(A)僅①② (B)僅②④ (C)僅①③ (D)僅③④
- 73 依據布拉克氏窩洞分類法 (Black's classification) 的定義，位於前牙的鄰接面，但不包括切緣角的窩洞屬於幾級窩洞？
(A)I 級窩洞 (B)II 級窩洞 (C)III 級窩洞 (D)IV 級窩洞
- 74 下列何種橋體與牙肉接觸範圍最大？
(A)衛生型 (hygienic type) (B)嵴疊形 (ridge lap type)
(C)船底型 (bilge type) (D)鞍狀型 (saddle type)
- 75 下列有關在金屬薄蓋冠的表面形成與陶瓷結合之氧化膜的敘述，何者正確？①貴重金屬合金需要兩次真空加熱處理 ②半貴重金屬合金加熱除氣後要用氧化鋁噴砂 ③非貴重金屬合金須在大氣中加熱除氣 ④所有金屬在加熱前都可以用噴砂處理
(A)僅①②③ (B)僅①②④ (C)僅②④ (D)僅④
- 76 固定牙橋的橋體長度增加時，可以減低失敗率的方法有那些？①在支柱牙的頰側與舌側修磨溝槽 ②在支柱牙的近心與遠心側修磨溝槽 ③增加橋體金屬支架 (metal framework) 的截面積 ④牙橋咬合面爲金屬 ⑤使橋體咬合面頰舌側寬度減少 ⑥採用彈性係數較低的金屬
(A)僅①②⑤⑥ (B)僅②③④⑤ (C)僅②③④⑥ (D)僅①③④⑤
- 77 下列那一種局部覆蓋冠較不常當成單顆補綴物？
(A)鄰接面半冠 (proximal-half crown) (B)針嵌體 (pinledge)
(C)7/8 牙冠 (seven-eighth crown) (D)3/4 牙冠 (three-quarter crown)
- 78 陶瓷橋體的設計若以清潔衛生爲考量，則其由優至劣之順序何者最正確？①偏側型 (flat back type) ②嵴疊型 (ridge lap type) ③船底型 (bilge type) ④離底型 (衛生型) (sanitary pontic) ⑤鞍狀型 (saddle type)
(A)④ > ③ > ② > ① > ⑤ (B)④ > ② > ① > ③ > ⑤
(C)⑤ > ② > ① > ③ > ④ (D)④ > ③ > ① > ② > ⑤
- 79 下列有關印製固定牙橋所用的個人牙托 (individual tray) 製作步驟，何者最正確？①牙托樹脂在硬化時應連同模型與 paraffin wax 放置熱水裡加速硬化 ②牙托與 paraffin wax 之間可放一層錫箔紙以免影響印模材與牙托間的黏著效果 ③上顎的牙托可以不需要覆蓋到全部的硬腭 (hard palate) ④需要在牙托內面設計 stopper 以保持印模材的均勻厚度
(A)僅①③ (B)僅①②④ (C)僅②③④ (D)僅①③④
- 80 陶瓷切緣側最適當的厚度約爲：
(A)1.2~1.4 mm (B)1.5~1.7 mm (C)1.8~2.0 mm (D)大於 2.1 mm